

LASER PROCESSING Technical Seminar

第3回 レーザ加工応用セミナー 《微細加工技術》

産業用途としてのレーザー加工技術は、板金の切断加工を基軸にして溶接や微細加工など種々の分野に用途を拡大・発展し、加工精度も極めて向上しつつあります。

近畿高エネルギー加工技術研究所（AMPI）は、ものづくり企業の皆様の新しいレーザー加工技術の導入にもつなげる『レーザー加工応用セミナー』を開催いたします。

今回は「レーザーによる微細加工技術」をテーマに、マイクロエレクトロニクスや半導体、医療機器製造などの産業における微細切断、穴あけ、スクライブ、表面改質など、ますます用途・加工対象材料が拡大しているレーザー微細加工技術について、世界トップシェアのファイバーレーザー機器メーカーである IPG フォトニクスジャパン様を講師にお招きし、短パルスレーザーの魅力を紹介していただきます。

レーザー加工技術に携わる若手の技術者、新しい加工技術に興味をお持ちの企業の皆様には是非ともご参加いただきたく、ご案内いたします。

◇日時 2022年8月23日(火) 14:00～17:00

◇会場 尼崎リサーチ・インキュベーションセンター (ARIC) 2階小ホール

◇定員 20名

◇講師 IPG フォトニクスジャパン(株) セールス&マーケティング部
プロダクトマネージャー 東谷 明郎 氏

◇プログラム

超短パルスレーザーを用いた微細加工技術

1. 加工ニーズを満たすレーザー光源と周辺機器選定
2. 超短パルスレーザーと微細加工アプリケーション例

◇参加費 一般 7,000円 AMPI 賛助会員 5,000円
参加申込書記載の指定口座への振込をお願いします。(当日現金支払も可)

◇申込み要領 添付「参加申込書」に必要事項をご記入のうえ、
8月18日(木)までに e-mail または Fax で申込みをお願いします。

◇問合せ先 (一財)近畿高エネルギー加工技術研究所 (AMPI)
ものづくり支援センター 研究開発部 殖粟(うめぐり)
TEL 06-6412-7800 FAX 06-6412-7776
E-mail info@ampi.or.jp